

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2001年3月8日 (08.03.2001)

PCT

(10)国際公開番号
WO 01/16878 A1

(51)国際特許分類:

G06K 19/077

(21)国際出願番号:

PCT/JP00/04335

(22)国際出願日: 2000年6月30日 (30.06.2000)

(25)国際出願の言語:

日本語

(26)国際公開の言語:

日本語

(30)優先権データ:

特願平11/244161 1999年8月31日 (31.08.1999) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): リン
テック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP];
〒173-0001 東京都板橋区本町23番23号 Tokyo (JP).

(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 市川 章
(ICHIKAWA, Akira) [JP/JP]. 渡辺健一 (WATANABE,
Kenichi) [JP/JP]; 〒173-0001 東京都板橋区本町23番
23号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

(74)代理人: 鈴木俊一郎 (SUZUKI, Shunichiro); 〒141-0031
東京都品川区西五反田七丁目13番6号 五反田山崎ビル6階
鈴木国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81)指定国(国内): CN, KR, SG, US.

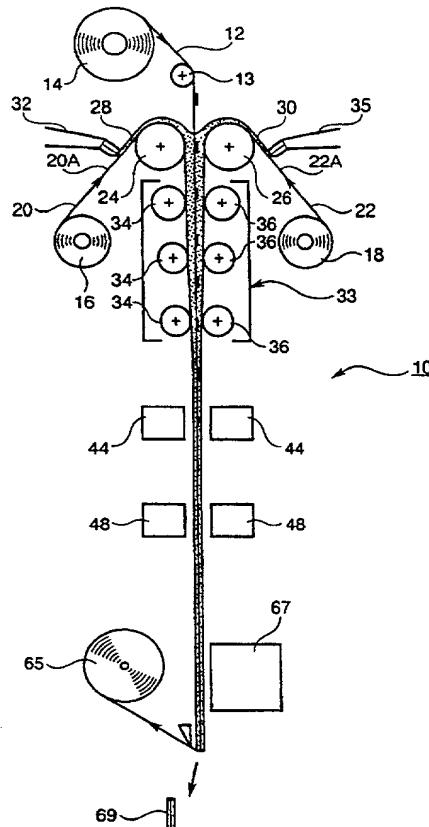
(84)指定国(広域): ヨーロッパ特許 (DE, FR, GB, IT).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: METHOD OF MANUFACTURING CARD

(54)発明の名称: カードの製造方法



(57) Abstract: A method of manufacturing a card wherein parts mounted or formed on a substrate, such as an IC chip, capacitors, and an antenna coil, cause no undulations to appear on the card surface. Substrates are continuously supplied together with a pair of sheet materials between which the substrates are inserted. Adhesive fluid is supplied between the sheet materials and the substrate and cured while keeping the distance between the pair of sheet materials constant.

WO 01/16878 A1

[続葉有]